

キズ防止転写型離型フィルムを新たに開発

ハリマ化成グループ株式会社

ハリマ化成株式会社（代表取締役社長：長谷川吉弘）は、半導体パッケージ製造工程のコンプレッション成形（圧縮成形）用のキズ防止転写型離型フィルムを開発しました。

コンプレッション成形において半導体パッケージの封止にシリコン樹脂を使用した場合、パッケージ表面にキズが付きやすい問題があります。当社が新しく開発した転写型離型フィルムは、キズ防止膜が成形時の熱と圧力により封止樹脂と密着し、一方でベースフィルム面とは剥離し転写するように設計されているため、パッケージ表面を守ることができます。さらに、従来のコンプレッション成形の装置や製造工程の変更を要しない利点があります。

コンプレッション成形は、高い生産性や封止樹脂の必要量低減、薄型半導体パッケージに適した工法として適用が進んでおり、今回開発した転写型離型フィルムの活用が広がると期待できます。

以上

図1. キズ防止転写型離型フィルムの構成

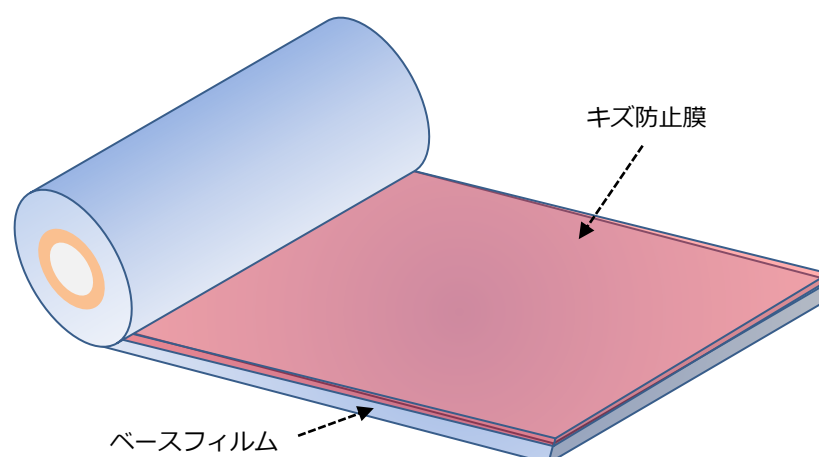
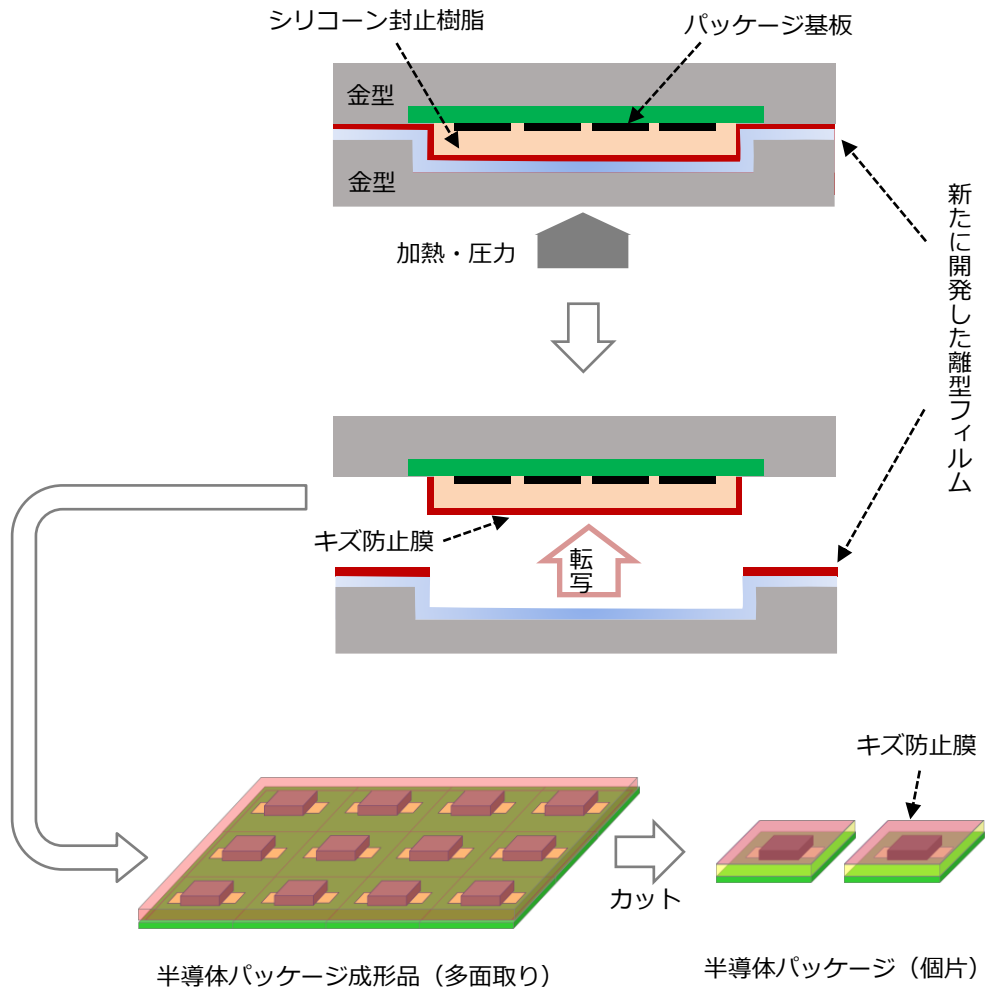


図2. コンプレッション成形（断面模式図）



本件に関するお問い合わせ先
ハリマ化成グループ株式会社 広報グループ
TEL : 06-6201-2477
URL : <https://www.harima.co.jp/inquiry.php>